

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-054

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 业绩预告的具体适用情形：净利润扭亏为盈。
- 公司预计2026年半年度实现营业收入209,500.00万元左右，同比增长约25.77%。
- 公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为8,500.00万元左右，同比扭亏为盈。
- 公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,000.00万元左右，同比扭亏为盈。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

- 1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现营业收入209,500.00万元左右，同比增长约25.77%。其中实现主营收入207,800.00万元左右，同比增长约25.79%。
- 2、预计实现归属于上市公司股东的净利润为8,500.00万元左右，同比扭亏为盈，利润将增加21,202.52万元左右。
- 3、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,000.00万元左右，同比扭亏为盈，利润将增加15,610.87万元左右。
- 4、预计2026年半年度实现EBITDA（息税折旧摊销前利润）80,000.00万元左右，与上年同

期相比增加33,741.96万元左右，同比增长约72.94%。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

- 1、营业收入：166,578.18万元。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：-12,702.52万元。
- 3、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-12,610.87万元。
- 4、EBITDA（息税折旧摊销前利润）：46,258.04万元。
- 5、每股收益：-0.19元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

（一）主营业务影响

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，主要得益于半导体硅片板块盈利能力的改善。随着产品结构持续向高端化迭代升级，产销规模的稳步扩张，尤其是12英寸硅片产销量实现大幅增长，硅片单位成本同步下降，硅片业务（含对立昂微母公司的销售）的综合毛利率同比上升。

报告期内，得益于半导体行业景气度的持续复苏，下游客户需求增长及公司加强市场拓展、优化产品结构等因素的影响，公司主要产品产销量变动如下：（1）半导体硅片（出货面积折合为6英寸）的销量约1,150.09万片（含对立昂微母公司的销量129.75万片），同比增长约23.95%，其中：12英寸硅片销量约112.64万片（折合6英寸约450.58万片），同比增长约38.81%。（2）半导体功率器件芯片销量约112.12万片，同比增长约19.02%。（3）化合物半导体射频及光电芯片销量约2.44万片，同比增长约78.33%。

（二）非经常性损益的影响

本报告期内，公司非经常性损益大幅增加，归属于上市公司股东的非经常性损益同比增加约5,560万元，主要系报告期内公司持有的上市公司股票股价上涨产生公允价值变动收益增加所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和

审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026年7月14日